

シングルワイヤーソー Single Wire Saw

MODEL WSD-K2

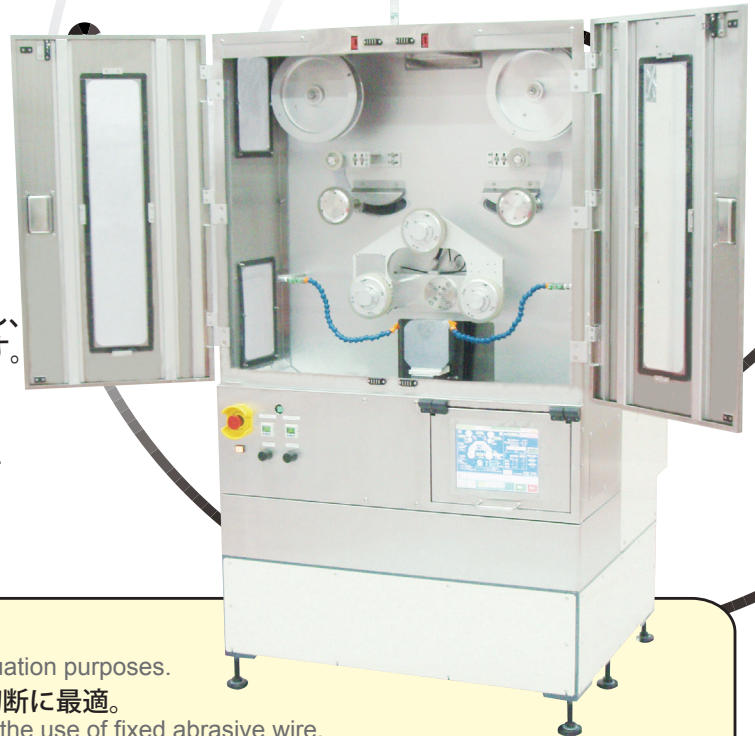
概要 Concept

量産用のマルチワイヤーソーに対し、
試作・評価用として1本のワイヤーで、
ワークを切断します。

Single wire saw best for sample
wafering for wafer evaluations.

固定砥粒を用い、脆性材料の端面出し、
少量ウェーハの切り出しに適しています。

With the use of fixed abrasive wire,
best suited for edge wafer cutting,
cropping and wafering in small quantity.



特長 Features

- ◎研究・試作に適した価格設定。
Reasonably priced for labs and evaluation purposes.
 - ◎固定砥粒を使い、試作・研究用切断に最適。
Best suited for sample wafering with the use of fixed abrasive wire.
 - ◎微調テーブル、複数本カット対応。(オプション)
Fine Tuning Table, Multiple work slicing specs available (option)
 - ◎高張力・揺動機構等の採用により、高精度切断を実現。
High precision slicing achieved by high wire tensioning & Takatori Original Rocking System.
 - ◎シンプル設計、タッチパネルによる簡単操作。
Simple mechanical design and easy operation with the use of Touch Panel Operation Screen.
- ※その他、幅広いご要望にもお応えします。

仕様 Specification

項目 Specifications	単位 Unit	WSD-K2
装置寸法 (W×H×D) Dimensions (W×H×D)	mm	1,000 × 1,750 × 1,070
装置重量 Weight	kg	約 500 Approx 500
最大ワーク寸法 (W×H×D) Max. Work dimensions (W×H×D)	mm	156 × 156 × 100
揺動角 Rocking Angle	度 deg	0 ~ ±10
最高線速 Max. Wire Speed	m/min	700
ワイヤー張力 Max. Wire Tension	N	40

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
Specs are subject to change without notice.